

平成 22 年 5 月 19 日

各 位

株 式 会 社 り そ な 銀 行

## 就活イベント～不況に負けない技術カンパニーフォーラム～の開催について

りそな銀行（社長 岩田 直樹）は平成 22 年 5 月 27 日（木）に大阪本社で「就活イベント ～不況に負けない技術カンパニーフォーラム」を開催いたします。

世界的な景気後退で人員削減が相次ぐ中でも、不況に負けずに業績を伸ばしているモノづくり企業は多数あります。この「就活イベント」は、そういった元気な技術力のある企業と、地元関西の優秀な学生との出会いの場を創出し、お取引先の採用活動を支援することを目的としています。

このイベントでは、出展企業の若手技術者や経営者自らが直接学生に語りかけたり、実際に自社の取扱製品を展示する場を提供いたします。参加した学生は、職場環境や技術力を身近に感じるこことが出来るなど、より充実した就職活動につなげるための工夫を行っています。

## 【イベント概要】

イベント名	就活イベント ～不況に負けない技術カンパニーフォーラム～
開催日時	平成 22 年 5 月 27 日（木） 13:00～17:00
開催場所	りそな銀行大阪本社地下 2 階レセプションホール 大阪府大阪市中央区備後町 2 丁目 2 番 1 号
主催	株式会社りそな銀行
後援	大阪商工会議所
イベントに関する お問い合わせ先	りそな銀行 法人ソリューション営業部（大阪） 御堂筋ビジネスソリューションプラザ 福田・井上 TEL:06-6202-1755
出展企業	朝日電器株式会社、石崎プレス工業株式会社、音羽電機工業株式会社、 株式会社信光ステンレス、株式会社たけでん、 日本化学機械製造株式会社、日本システム技術株式会社、 日本電通株式会社、株式会社フジキン、株式会社フジワーク

以上